

	A会場	B会場	C会場	D会場
9:50	<p><b>[1A1] パワエレ-1 パッケージング</b></p> <p>1. 次世代環境対応車向けパワーエレクトロニクス技術 ○広瀬 敏 (トヨタ自動車) (依頼講演 40分)</p> <p>2. 175°C連続動作を保證する IGBT モジュールのパッケージ技術 ○齊藤 隆, 西村芳孝, 両角 朗, 玉井雄大, 百瀬文彦, 望月英司, 高橋良和 (富士電機)</p> <p>3. 高信頼接合技術の車載用直接水冷パワーモジュールへの適用 ○玉井雄大, 両角 朗, 齊藤 隆, 百瀬文彦, 西村芳孝, 望月英司, 高橋良和 (富士電機)</p> <p>4. ラマン分光法を用いた SiC MOSFET の応力の温度依存性評価 ○内田智之, 小坂賢一, 遠藤 亮, 山元隆志, 杉江隆一 (東レリサーチセンター)</p>	<p><b>[1B1] 配線基板・インターポーザ</b></p> <p>1. 狭間隔部品内蔵技術によるキャパシタ内蔵インターポーザの開発 ○菊地克弥<sup>1</sup>, 氏家昌章<sup>2</sup>, 青柳昌宏<sup>1</sup>, 高山慎也<sup>2</sup> (<sup>1</sup>産総研, <sup>2</sup>アリナ)</p> <p>2. 低そりを実現する新規 IC パッケージ用ビルドアップ材料 ○田中照久, 田中俊章, 林 達史, 國川智輝, 白波瀬和孝 (積水化学工業)</p> <p>3. 電源ノイズを低減させるビルドアップ基板のピスタック構造の開発 ○赤星知幸<sup>1</sup>, 福盛大雅<sup>1</sup>, 水谷大輔<sup>1</sup>, 谷元昭<sup>1</sup>, 阿部健一郎<sup>2</sup>, 馬場俊二<sup>3</sup>, 小出正輝<sup>3</sup> (<sup>1</sup>富士通研究所, <sup>2</sup>富士通インターコネクテクトテクノロジーズ, <sup>3</sup>富士通アドバンステクノロジ)</p> <p>4. 銅のエッチングレートに結晶方位が与える影響 ○久保田賢治<sup>1</sup>, 関下明日香<sup>2</sup>, 吉原佐知雄<sup>3</sup>, 松本克才<sup>2</sup> (<sup>1</sup>三菱マテリアル, <sup>2</sup>八戸工業高等専門学校, <sup>3</sup>宇都宮大学)</p> <p>5. デスマリア工程に対応可能な無電解めっき向けポリイミドフィルムとビルドアップ工程への適応検討 ○横沢伊裕, 三浦 徹, 幸田政文 (宇都興産 有機機能材料研究所)</p>	<p><b>[1C1] 高速高周波・電磁特性技術</b></p> <p>1. Power Distribution Network 反共振ピークのオンボード抑制手法 ○山口冬生, 須藤俊夫, 栗田加奈絵 (芝浦工業大学)</p> <p>2. DC/DC コンバータのノイズ低減設計・解析手法 ○寺崎正洋, 富永創一, 大橋祐太, 益山 曜, 須藤俊夫 (芝浦工業大学)</p> <p>3. 薄膜キャパシタ内蔵インターポーザによる LSI 動作周波数の向上 ○服部篤典<sup>1</sup>, 張 維<sup>1</sup>, 高松淳一<sup>1</sup>, 波多野孝<sup>1</sup>, 尾関靖幸<sup>1</sup>, 小山田成聖<sup>2</sup>, 吉澤正充<sup>2</sup> (<sup>1</sup>野田スクリーン, <sup>2</sup>テクノエクスセル)</p> <p>4. 再配線技術を用いたテラヘルツ帯域用アンテナ一体型モジュール構造の開発 ○石橋大二郎, 佐々木伸也, 石月義克, 飯島真也, 中田義弘, 川野陽一, 鈴木俊秀, 谷 元昭 (富士通研究所)</p> <p>5. プリント配線板上に形成した UWB アンテナの検討 ○百瀬大祐, 山本隆彦, 越地耕二 (東京理科大学)</p>	<p><b>[1D1] ものづくりセッション-1</b></p> <p>1. 次世代型 LED 基板対応オーバーコートガラス 横道公伸 (興野製薬工業)</p> <p>2. 放熱用絶縁高熱伝導フィルム 青木一生 (ナミックス)</p> <p>3. インジェクションプロセス開発用単ノズルヘッド 矢部雄一 (クラスターテクノロジー)</p> <p>4. タッチパネルなどの欠陥検査 &amp; リペアー連化システム 加藤好志 (アプライド・マイクロシステム)</p> <p>5. 無電解めっき下地層に適した熱硬化型ペースト 津野勇輝 (興野製薬工業)</p>
11:30	<p><b>[1A2] パワエレ-2 放熱材料・技術</b></p> <p>1. Thermal Interface Material の静電容量測定に関する検討 ○斎藤弘弘, 鈴木 悟, 小室貴紀 (神奈川工科大学)</p> <p>2. 炭素系異方伝熱材料のパワー半導体用放熱板への可能性 ○久野敦輝<sup>1</sup>, 澤木聖斗<sup>1</sup>, 成田恭典<sup>1</sup>, 山田 靖<sup>1</sup>, 竹馬克洋<sup>2</sup> (<sup>1</sup>大同大学, <sup>2</sup>サマーグラフィティクス)</p> <p>3. 熱輸送特性を反映したヒートパイプ付きヒートシンクの熱解析技術 ○山口 翔, 松田良太郎 (東芝ライテック)</p> <p>4. 高熱伝導・熱応力緩和性を有するアルミニウム/グラファイト積層ロール型複合材の開発 ○山田由香, 北條 浩, 木村英彦, 川本敦史, 松森唯益, 近藤雅男 (豊田中央研究所)</p> <p>5. 金属メッシュを用いた伝熱材料の評価 ○鈴木 悟, 斎藤靖弘, 小室貴紀 (神奈川工科大学)</p>	<p><b>[1B2] ヘルスケア</b></p> <p>1. 光子イメージングによる画像ナビゲーション手術 ○高松哲郎 (京都府立医科大学) (依頼講演 40分)</p> <p>2. 印刷工法により作製した伸縮性電極の特性評価と生体信号計測への応用 ○井上雅博<sup>1</sup>, 多田泰徳<sup>1</sup>, 板橋洋介<sup>2</sup>, 天野祐作<sup>3</sup>, 得丸智弘<sup>4</sup> (<sup>1</sup>群馬大学先端科学研究指導者育成ユニット, <sup>2</sup>群馬大学院, <sup>3</sup>群馬大学工学部, <sup>4</sup>バイオシグナル)</p> <p>3. 医療分野への応用を目的とした磁性めっき膜の解析 ○山口大輝<sup>1</sup>, 玉木一馬<sup>1</sup>, 高梨 博<sup>1</sup>, 渡辺宜朗<sup>1</sup>, 小幡 勲<sup>2</sup>, 小岩一郎<sup>1</sup> (関東学院大学, <sup>2</sup>富山県工業技術センター)</p> <p>4. 人体通信とパーソナルエリアネットワークを想定したウェアラブル電極 ○越地福朗 (東京理科大学)</p>	<p><b>[1C2] プリントブルエレクトロニクス</b></p> <p>1. 線幅 5 μm が描線できるニードル式ディスプレイ ○加藤好志<sup>1</sup>, 平田 淳<sup>2</sup> (<sup>1</sup>アプライド・マイクロシステム, <sup>2</sup>日本電子精機)</p> <p>2. ナノインクの直接印刷を用いた GaN 系発光ダイオードの電極形成 ○柏木行康<sup>1</sup>, 小泉 淳<sup>2</sup>, 竹村康孝<sup>3</sup>, 垣内宏之<sup>4</sup>, 古田晋也<sup>5</sup>, 山本真理<sup>1</sup>, 斎藤大志<sup>1</sup>, 高橋雅也<sup>1</sup>, 大野敏信<sup>1</sup>, 藤原康文<sup>2</sup>, 児島貴徳<sup>2</sup>, 村橋浩一郎<sup>3</sup>, 大塚邦顕<sup>3</sup>, 青柳伸宜<sup>1</sup>, 吉田幸雄<sup>1</sup>, 中許昌美<sup>1</sup> (大阪市立工業研究所, <sup>2</sup>大阪大学大学院工学研究科, <sup>3</sup>興野製薬工業, <sup>4</sup>大研化学工業, <sup>5</sup>巴製作所)</p> <p>3. 焼成フリー金属ナノインクを用いたプリントデバイスの開発 ○金原正幸<sup>1</sup>, 三成剛生<sup>2</sup> (<sup>1</sup>岡山大学, <sup>2</sup>物質材料研究機構)</p> <p>4. 低温焼結性銅材料の開発 ○井田清信, 渡辺 満, 磯部 薫 (石原産業)</p> <p>5. 超微細インジェクションと酸素ポンプを用いたドライプロセスによる狭ピッチ銅配線 ○白川直樹<sup>1</sup>, 梶原康一<sup>2</sup>, 柏木行康<sup>3</sup>, 古宮大輔<sup>4</sup>, 宮川俊彦<sup>4</sup>, 村田和広<sup>4</sup> (産業技術総合研究所, <sup>2</sup>イオックス, <sup>3</sup>大阪市立工業研究所, <sup>4</sup>SIJ テクノロジ)</p>	<p><b>[1D2] ものづくりセッション-2</b></p> <p>1. 電子機器実装用低温・短時間硬化接着剤 徳平英士 (富士通クオリティ・ラボ)</p> <p>2. 最新 CR-8000 の部品内蔵基板対応 CAD 技術 松澤浩彦 (図研)</p> <p>3. ドライ表面処理のプロセス管理について -インジケータによる処理強度の見える化- 上山浩幸 (JCU)</p> <p>4. ナノ銀触媒を用いた無電解めっきプロセス; NACE プロセス 清水 優 (興野製薬工業)</p> <p>5. 多様なニーズに応えるピアフィリング用硫酸銅めっき添加剤トップリチナ IV, VT, HV 大石晃弘 (興野製薬工業)</p>
14:00	ものづくりコアタイム			
14:00	U3 棟 211			
15:00	MES2013 表彰式			
15:20	招待講演			
16:20	招待講演			
17:20	招待講演			

A会場: U2 棟 311  
 B会場: U2 棟 312  
 C会場: U2 棟 213  
 D会場: U2 棟 214  
 大学研究室/ものづくり展示コーナー  
 U2 棟 212

17:40 交流会  
 会場: ラ・シェーナ (大阪大学構内)  
 19:40



	A会場	B会場	C会場	D会場
9:00	<p><b>[2A1] パワエレ-3 耐熱材料・評価</b></p> <p>1. 過渡熱測定によるSiCパワーデバイスの放熱特性評価と応用 ○遠藤 亮, 渡邊淳一, 杉江隆一, 山元隆志 (東レリサーチセンター)</p> <p>2. パワーエレクトロニクス分野に向けたシート状エポキシ樹脂の開発と展開 ○上野健一, 石川有紀, 土肥一博 (サンユレック)</p> <p>3. 高耐熱性多官能メソゲン骨格エポキシ樹脂の開発 ○森岡大智, 原田美由紀, 越智光一 (関西大学)</p> <p>4. 配列構造の異なるポリドメイン液晶エポキシ樹脂の熱伝導性 ○山口大輔, 原田美由紀, 越智光一 (関西大学)</p>	<p><b>[2B1] めっき技術-1</b></p> <p>1. 電気化学的手法によるポリイミド系樹脂上への金属薄膜形成プロセス ○木村祐介<sup>1</sup>, 藤原良輔<sup>1</sup>, 高島洋平<sup>1</sup>, 鶴岡孝章<sup>1</sup>, 細舟秀美<sup>1</sup>, 柳本 博<sup>2</sup>, 赤松謙祐<sup>1</sup> (甲南大学, <sup>2</sup>トヨタ自動車)</p> <p>2. 銀ナノ粒子インクの印刷と銅めっきによる配線形成における銀層と基材間の密着性 ○村川 昭, 富士川直, 義原 直, 白髪潤 (DIC)</p> <p>3. 硫酸銅電気めっき液中における一価銅の生成とめっき皮膜の評価 ○古賀淑智, 平川智恵子, 野間弘昭, 野中一洋 (産業技術総合研究所)</p> <p>4. 感光性金属錯体及びUV表面改質を用いた高解像度金属パターン形成 ○Christopher Cordonier (関東学院大学)</p>	<p><b>[2C1] 最先端材料</b></p> <p>1. 次世代Agレスはんだを用いた部品への適用検討 ○早川隆範<sup>1</sup>, 岡田裕和<sup>1</sup>, 伊東 広<sup>2</sup>, 吉川俊作<sup>2</sup>, 萩原嵩史<sup>2</sup>, 土門孝彰<sup>1</sup> (TDK, <sup>2</sup>千住金属工業, <sup>3</sup>TDK 由利本社)</p> <p>2. はんだ接合部微細化によるはんだ/Cu界面への影響 ○宇治野真<sup>1</sup>, 西川 宏<sup>2</sup> (大阪大学 大学院, <sup>2</sup>大阪大学 接合科学研究所)</p> <p>3. 接着剤併用型Sn-Bi はんだペーストの開発 ○北村和夫, 八木友久, 伊達仁昭, 山岸康男 (富士通クオリティ・ラボ)</p> <p>4. グリジリアミン系バインダを用いた導電性接着剤の電気伝導特性に及ぼすアミン系硬化剤の影響 ○坂庭慶昭<sup>1</sup>, 多田泰徳<sup>2</sup>, 井上雅博<sup>2</sup> (群馬大学大学院, <sup>2</sup>群馬大学先端科学研究指導者育成ユニット)</p>	<p><b>[2D1] 信頼性技術-1</b></p> <p>1. 部品内蔵基板用静電容量型検査システムの開発 ○野口祐智 (電機大)</p> <p>2. 3次元デジタル画像相関法による発光ダイオードの変形計測 ○田口秀幸, 池田健一, 森野勝也, 三宅修吾 (コベルコ科研)</p> <p>3. 残留分極による電子部品実装工程向けフレキシブル基板吸着技術の評価 ○川本竜輔<sup>1</sup>, Bock Karlheinz<sup>2</sup>, Christof Landesberger<sup>2</sup> (パナソニックファクトリーソリューションズ, <sup>2</sup>Fraunhofer EMFT)</p> <p>4. 組込み型電気検査回路によるICのピン浮き検査可能性実験 ○梅津翔一, 四柳浩之, 橋爪正樹 (徳島大学大学院)</p>
10:20	<p><b>[2A2] パワエレ-4 接合プロセス技術 1</b></p> <p>1. SiCパワーデバイス向け接合技術の開発 ○佐藤 弘<sup>1</sup>, 高橋弘樹<sup>1</sup>, 谷澤秀和<sup>1</sup>, 安在岳志<sup>1</sup>, 樋山浩平<sup>1</sup>, 加藤史樹<sup>1</sup>, 佐藤伸二<sup>1</sup>, 村上善則<sup>1</sup>, 仲川 博<sup>1</sup>, 山口 浩<sup>1</sup> (次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構 (FUPEP), <sup>2</sup>産業技術総合研究所, <sup>3</sup>富士電機, <sup>4</sup>サンケン電機, <sup>5</sup>カルソニックカンセイ, <sup>6</sup>東芝, <sup>7</sup>日産自動車) (依頼講演 40分)</p> <p>2. 表面活性化接合法に基づいてSiCウェハ接合 ○Fengwen MU, Tadatomo Suga, Masahisa Fujino (the University of Tokyo)</p> <p>3. Auナノボラス接合の接合材表面構造と接合強度の関係 ○松永香織<sup>1</sup>, Min-Su Kim<sup>1</sup>, 西川 宏<sup>2</sup>, 齋藤美紀子<sup>3</sup>, 水野 潤<sup>3</sup> (大阪大学, <sup>2</sup>大阪大学接合科学研究所, <sup>3</sup>早稲田大学ナノ理工学研究機構)</p> <p>4. 酸化銅ペースト接合における接合パラメータが接合性に及ぼす影響 ○藤本智之, 小原 智, 佐野智一, 廣瀬明夫 (大阪大学大学院)</p>	<p><b>[2B2] MEMS・先端アプリケーション</b></p> <p>1. センサネットワーク電源向け小型振動発電デバイスの開発 積 知範 (オムロン) (依頼講演 40分)</p> <p>2. 水素ラジカル処理したはんだを用いた低温固相接合技術の開発と気密封止パッケージングへの応用 ○日暮栄治<sup>1</sup>, 川合結夢<sup>1</sup>, 須賀唯知<sup>1</sup>, 岡田咲枝<sup>2</sup>, 萩原泰三<sup>3</sup> (東京大学, <sup>2</sup>千住金属工業, <sup>3</sup>神港精機)</p> <p>3. マイクロ流体有機発光素子の作製と評価 ○笠原崇史<sup>1</sup>, 津脇美帆<sup>1</sup>, 松波成行<sup>2</sup>, 江面知彦<sup>2</sup>, 大島寿郎<sup>2</sup>, 庄子習一<sup>1</sup>, 安達千波矢<sup>2</sup>, 水野 潤<sup>1</sup> (早稲田大学, <sup>2</sup>九州大学, <sup>3</sup>日産化学工業)</p> <p>4. 高精度ガス補正機能を有したMEMS熱式フローセンサの開発 ○山本克行 (オムロン)</p>	<p><b>[2C2] 先端インターコネクト-1</b></p> <p>1. シリコフォトニクスプラットフォーム用光電ハイブリッド集積チップ実装技術 ○磯水光男, 武田浩太郎, 平田泰典, 福田 浩, 土澤 泰, 高 磊, 本田健太郎, 野河正史, 山田浩治, 山本 剛 (NTT)</p> <p>2. Sn-Bi-Ag はんだ粒子-エポキシ混合系によるマイクロバンプ形成に及ぼすパターン基板表面の前処理の効果 ○安田清和 (大阪大学)</p> <p>3. その場観察による先鋭マイクロバンプの常温接合挙動の調査 ○首藤高徳, 浅野龍正 (九州大学)</p> <p>4. 高耐熱性・高解像度のレジストを用いた新規バンプ形成プロセス ○高橋誠一郎<sup>1</sup>, 武川 純<sup>1</sup>, 長谷川公一<sup>1</sup>, 楠本士朗<sup>1</sup>, 猪俣克巳<sup>1</sup>, 青木豊広<sup>2</sup>, 鳥山和重<sup>2</sup>, 折井靖光<sup>2</sup> (JSR, <sup>2</sup>日本アイ・ピー・エム)</p> <p>5. 溶解はんだインジェクション法によるウエハ上へのファインピッチはんだバンプ形成技術 ○鳥山和重, 青木豊広, 森 裕幸, 折井靖光 (日本アイ・ピー・エム)</p>	<p><b>[2D2] 3次元ICパッケージ</b></p> <p>1. 銅めっきにおける一価銅と添加剤による析出反応への影響 ○西村光平, 岡本尚樹, 齋藤文靖, 横井昌幸, 近藤和夫 (大阪府立大学)</p> <p>2. ビア底部の1価銅イオン濃度とめっき電流密度の関係 ○林 太郎, 横井昌幸, 岡本尚樹, 齋藤文靖, 近藤和夫 (大阪府立大学)</p> <p>3. 無電解CoWBめっき膜上へのCu置換めっきの形成と密着性評価 ○太田晃平<sup>1</sup>, 井上史大<sup>2</sup>, 清水智弘<sup>1</sup>, 新宮原正三<sup>1</sup> (関西大学, <sup>2</sup>東北大学)</p> <p>4. 3D-IC用層間材料における無機フィラーの検討 ○山本英広<sup>1</sup>, 杉山雅哉<sup>1</sup>, 池本 慎<sup>1</sup>, 桐谷秀紀<sup>1</sup>, 河瀬康弘<sup>1</sup>, 松本圭司<sup>2</sup>, 森 裕幸<sup>2</sup>, 折井靖光<sup>2</sup> (三菱化学, <sup>2</sup>日本アイ・ピー・エム)</p> <p>5. Si/Cu同時研削と残留金属低減処理を用いた微細TSV露出工程の開発 ○渡辺直也<sup>1</sup>, 青柳昌宏<sup>1</sup>, 片川大輔<sup>2</sup>, 三井貴彦<sup>3</sup>, 山本栄一<sup>3</sup> (産業技術総合研究所, <sup>2</sup>アブリアテクノロジー, <sup>3</sup>岡本工作機械製作所)</p>
12:10 12:40	ものづくりコアタイム			
13:30	<p><b>[2A3] パワエレ-5 接合プロセス技術 2</b></p> <p>1. 次世代パワーデバイス向けシインター銀ペーストの開発 ○栗田 哲, 遠藤圭一, 三好宏昌 (DOWA エレクトロニクス)</p> <p>2. 高耐熱性を有する銀ナノ粒子接合材料の開発 ○渡辺智文, 武居正史, 下山賢治 (バンドー化学)</p> <p>3. SiC粒子を添加した銀ペースト焼結接合 ○張 昊, 長尾至成, 朴 聖源, 菅原 徹, 菅沼克昭 (大阪大学産業科学研究所)</p> <p>4. Agナノ粒子焼結体の低サイクル疲労寿命におよぼす保持時間およびひずみ速度の影響 ○潮来真直<sup>1</sup>, 塩田竜太郎<sup>2</sup>, 荻谷義治<sup>2</sup>, 水村宜司<sup>3</sup>, 佐々木幸司<sup>3</sup> (芝浦工業大学大学院, <sup>2</sup>芝浦工業大学, <sup>3</sup>ナミックス)</p> <p>5. Sn0.7 はんだにおけるエレクトロマイグレーション現象 ○門口卓矢<sup>1</sup>, 山中公博<sup>2</sup> (トヨタ自動車, <sup>2</sup>中京大学)</p>	<p><b>[2B3] 先端インターコネクト-2</b></p> <p>1. Cu-NiO 混合ナノ粒子による無加圧接合 ○佐藤敏一, 石崎敏孝 (豊田中央研究所)</p> <p>2. Agナノ粒子の合成条件と接合特性の検討 ○小賀俊輔, 長尾至成, 酒 金婷, 菅原 徹, 菅沼克昭 (大阪大学産業科学研究所)</p> <p>3. 磁界によりSn結晶方位を配向するはんだ接合部の高信頼化技術 ○山中公博<sup>1</sup>, 西川 宏<sup>2</sup>, 田口博久<sup>1</sup>, 原田美由紀<sup>3</sup>, 越智光一<sup>3</sup> (中京大学, <sup>2</sup>大阪大学, <sup>3</sup>関西大学)</p> <p>4. 金属微粉末を用いた低温焼結接合技術における焼結温度条件の検討 ○成澤弘純<sup>1</sup>, 倉持 謙<sup>1</sup>, 藤野真久<sup>1</sup>, 日暮栄治<sup>1</sup>, 須賀唯知<sup>1</sup>, 白鳥俊幸<sup>2</sup>, 水野正孝<sup>3</sup> (東京大学, <sup>2</sup>アルファードデザイン, <sup>3</sup>SYNDEO)</p> <p>5. ボイドフリー親水化接合のための拡張表面活性化接合プロセス ○Ran He<sup>1</sup>, Masahisa Fujino<sup>1</sup>, Akira Yamauchi<sup>2</sup>, Tadatomo Suga<sup>1</sup> (the University of Tokyo, <sup>2</sup>Bondtech)</p>	<p><b>[2C3] 信頼性技術-2</b></p> <p>1. LEDパッケージの最新課題とその対策 ○宮脇芳照 (サンユレック)</p> <p>2. 高加速湿度評価の現状と課題-HAST, Air-HASTを中心として ○津久井勲<sup>1</sup>, 岡本秀孝<sup>2</sup>, 佐々木喜七<sup>2</sup> (リサーチラボ・ツクイ, <sup>2</sup>日本電子部品信頼性センター)</p> <p>3. Interconnect Stress Test方法によるプリント配線板接続信頼性の加速相関評価 ○安陪光紀, 菅根光彦 (富士通アドバンステクノロジー)</p> <p>4. Sn-Zn鉛フリーはんだの電気化学腐食挙動 ○Jian-Chun Liu<sup>1</sup>, 長尾至成<sup>1</sup>, 朴 聖源<sup>1</sup>, 菅原 徹<sup>1</sup>, Ju-Sheng Ma<sup>2</sup>, Gong Zhang<sup>2</sup>, 菅沼克昭<sup>1</sup> (Osaka University, <sup>2</sup>Tsinghua University)</p> <p>5. Cuワイヤパッケージの高温保存性にモールド樹脂特性が及ぼす影響 ○倉谷英敏, 石井秀基, 英賀文昭, 吾妻浩介 (ルネサスセミコンダクタパッケージ&amp;テストソリューションズ)</p>	<p><b>[2D3] 3D、2.5D実装技術における要求事項と開発動向 (各25min)</b></p> <p>13:30 ~ 13:55</p> <p>1. 次世代ハイ・エンド・モジュール実現へ向けた実装技術とインターポザー基板への要求 森 裕幸 (日本アイ・ピー・エム)</p> <p>13:55 ~ 14:20</p> <p>2. 2.5D用高密度パッケージの開発 清水規良 (新光電気)</p> <p>14:20 ~ 14:45</p> <p>3. 次世代有機微細配線技術(MCM &amp; 2.5Dインターポザー) 寺田健司 (京セラS L Cテクノロジー)</p> <p>14:45 ~ 15:10</p> <p>4. 3次元パッケージソリューション開発の取り組み 岩崎俊寛 (ジェイデバイス)</p>
15:10	<p><b>[2A4] 触って納得！ 近未来のコア技術</b></p> <p>1. システムデザインで広がる未来～来て見て触って3D設計～ 佐藤了平 (大阪大学) (依頼講演 40分)</p> <p>2. ウェアラブル・コミュニケーションの切り札～人体通信の最新動向～ 加藤康男 (カイザーテクノロジー) (依頼講演 40分)</p> <p>3. オープンディスカッション：「未来技術をみんなで言いたい放題！」</p>	<p><b>[2B4] めっき技術-2</b></p> <p>1. 電析法によるCo基ホイスラー合金薄膜の作製 ○渡辺宜朗, 山口大輝, 田杉直也, 山本晃弘, 佐野克仁, 小岩一郎 (関東学院大学)</p> <p>2. 高融点電気Bi合金めっきの検討 ○吉澤卓史, 田中 薫 (石原ケミカル)</p> <p>3. 置換型無電解パラジウムめっきプロセスの優位性 ○亀井 勝, 渋谷宏明, 珍田 聡 (JX 金属商事)</p>	<p><b>[2C4] 信頼性技術-3</b></p> <p>1. 粘弾性物性の熱履歴を考慮した電子パッケージの反りヒステリシス解析 ○池田 徹<sup>1</sup>, 尾崎秋子<sup>1</sup>, 畑尾卓也<sup>2</sup>, 中井戸宙<sup>2</sup> (鹿児島大学, <sup>2</sup>住友ベークライト)</p> <p>2. ロックイン発熱解析を用いた故障解析ソリューション ○今井康雄, 浅井憲二, 味岡恒夫, 中村隆治, 山本 剣 (沖エンジニアリング)</p> <p>3. 電気-熱-構造連成解析を用いた車載用パワーモジュールの評価方法の確立 ○森田潤隆 (横浜国立大学)</p> <p>4. 樹脂材のはく離強度の評価手法に関する研究 ○本田興久<sup>1</sup>, 于 強<sup>1</sup>, 草間竜一<sup>2</sup>, 畑尾卓也<sup>3</sup> (横浜国立大学大学院, <sup>2</sup>デンソー, <sup>3</sup>住友ベークライト)</p> <p>5. Embedded Wafer Level BGAパッケージの落下衝撃信頼性におよぼすポリイミド再配線層の影響 ○下田秀治<sup>1</sup>, 荻谷義治<sup>2</sup>, 藤田 充<sup>3</sup> (芝浦工業大学大学院, <sup>2</sup>芝浦工業大学工学部, <sup>3</sup>旭化成イーマテリアルズ)</p>	
17:00				